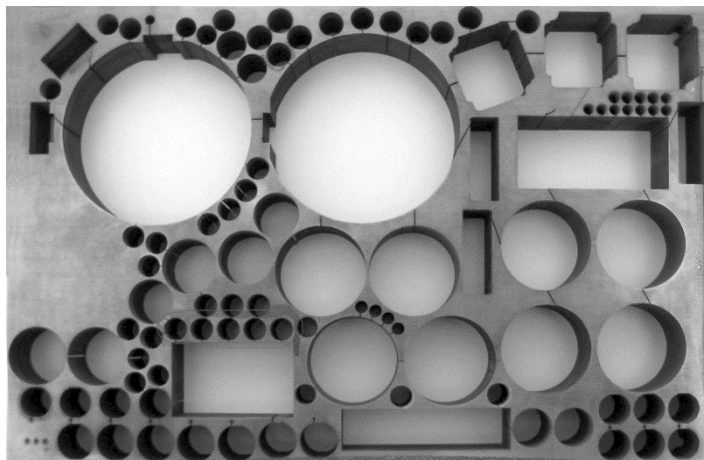


镍磷镀层厚度可达 8 MM

适用于超精密加工工艺



层厚为 7 mm 且均匀的电解镍磷镀层，预铣削并可立即用于打造纳米精度结构。



从镍磷镀层板上切割出用于高精密切削加工的元件。

对以下结构，镍磷电解镀层具有不可超越的尖端优势:

- 微流控芯片/微流体注塑成型
- 微结构、晶体结构
- 衍射光学结构（衍射光栅，衍射光学元件 DOE）
- 线性结构表面
- 自由曲面
- 柱面透镜、复曲面、棱镜
- 菲涅尔透镜
- 光学表面 <1 mm 的微透镜和棱镜
- 透镜阵列

ELEKTROFORM 电解镍磷镀层技术属性：

- 非晶态，磷含量约为 12 - 14 %
- 抗磁性
- 完美适用于金刚石切削
- 最大镀层尺寸：500 x 500 mm
- 最大镀层厚度：8 mm
- 硬度：580 - 620 维卡（Vickers）

更多信息 - 欢迎致电我们！

www.elektroform.eu